



公益財団法人
かがわ産業支援財団



一般社団法人
電気学会

微細構造デバイス研究開発フォーラム 令和7年度セミナー・見学会(2部制)

「新世代における自動車半導体センサの現状と将来展望」

このセミナーでは、業界の専門家が微細デバイス構造の最新技術や応用について詳しく解説します。技術者や研究者の方はもちろん、興味のある方ならどなたでも参加可能です！

日時

令和7年 **12月11日(木)**
13:30~16:50

会場

香川産業頭脳化センタービル2階
一般研修室

※第1部 セミナーはオンライン(Zoom)参加可

事前申込制
参加無料

第1部 セミナー (13:30~16:00)

※オンライン参加可

講演①

CMOS イメージセンサの進化と
自動車にむけた応用展開

静岡大学 電子工学研究所

教授 **川人 祥二 氏**

講演②

自動車用センサの現在と将来展望

株式会社ミライズテクノロジーズ
センサ研究開発部

部長 **和戸 弘幸 氏**

第2部 見学会 (16:05~16:50)

【微細構造デバイス研究開発設備 (FROM 香川メカトロ研究室)】 ※会場参加者のみ

微細構造デバイス研究開発フォーラム 会長

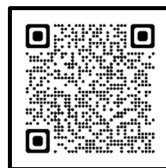
一般社団法人電気学会 四国支部長

香川大学 微細構造デバイス統合研究センター センター長・教授 **高尾 英邦**

申込方法 (第1部(セミナー)または第2部(見学会)のみへの参加も可能です。)

参加御希望の方は、次のいずれかの方法でお申込みください。

- ① Web フォームで申込(右の二次元コード)
(<https://kagawa-isf.form.kintoneapp.com/public/device-moushikomi>)
- ② 裏面の参加申込書をメール又はFAXで提出



〈申込期限〉令和7年11月28日(金)

主催者等：微細構造デバイス研究開発フォーラム、公益財団法人かがわ産業支援財団
一般社団法人電気学会 四国支部、香川大学 微細構造デバイス統合研究センター

微細構造デバイス研究開発フォーラム令和7年度セミナー・見学会申込書

○申込先：メール：sgk@kagawa-isf.jp FAX：087-864-6303

○申込期限：令和7年11月28日（金）

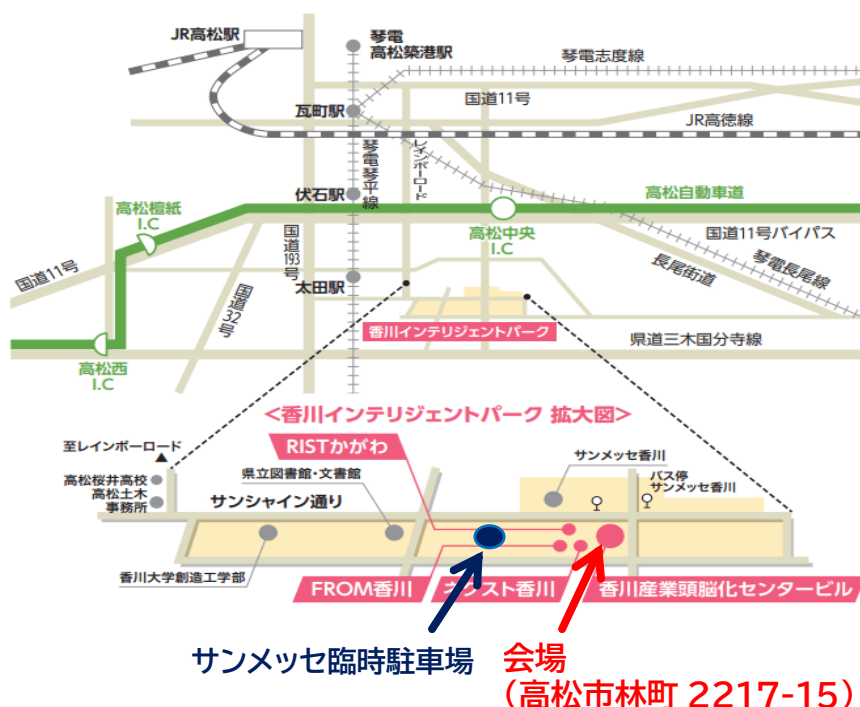
○問合せ先：（公財）かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課 熊谷
TEL：087-840-0338

参加者の情報		
企業・所属団体名		
参加者	役職名	氏名
住所	〒	
連絡先	TEL () -	
	E-mail @	
参加内容		
・本会はセミナーと見学会の「2部制」となります。 ・第1部（セミナー）のみへの参加も可能です。		
☐ 第1部 セミナーに参加 （右から参加方法もお選びください。）	☐ 会場参加	
	☐ オンライン参加※1	
☐ 第2部 見学会に参加 （※会場参加者のみ）		

※1 メール受信の制限を行っている場合は、招待メールの差出人のドメイン（@kagawa-isf.jp）を拒否しないようお願いします。

※ご記入いただいた個人情報は適切に管理いたします。
なお、当財団が実施するセミナー案内等をお送りさせていただく場合がございます。

【会場周辺図】



【交通アクセス】

JR 高松駅から

- ・車で約25分
- ・ことでんバス
サンメッセ・川島・西植田線
「サンメッセ香川」下車すぐ

ことでん伏石駅から

- ・ことでんバス
伏石駅サンメッセ線
「サンメッセ香川」下車すぐ

車でお越しの場合

来客用駐車場には限りがあるため、サンメッセ香川向かい「臨時駐車場」をご利用ください。
なお、契約者専用駐車場への駐車は厳禁です。
契約駐車スペースに駐車されている場合、呼出・移動をお願いすることがあります。